

CEOインタビュー



Accelerating technology development

Technological innovation creates value for stakeholders

Q 2013年3月期は、東京エレクトロンの事業戦略において、どのような位置付けの年でしたか？

A 2013年3月期は、低迷するマクロ経済の影響もあり、お客さまの設備投資が抑制されるなど、当社にとって厳しい事業環境となりました。その一方、中長期的には、半導体がさまざまな技術的な変革点を迎えつつあり、当社は、こうした新技術への移行をビジネス拡大の好機と捉え、自社開発の強化に加えて、大学やコンソーシアムとの共同開発の推進、企業買収による新技術の獲得など、将来の成長に向けた布石をこれまで以上に積極的に投じた一年でありました。

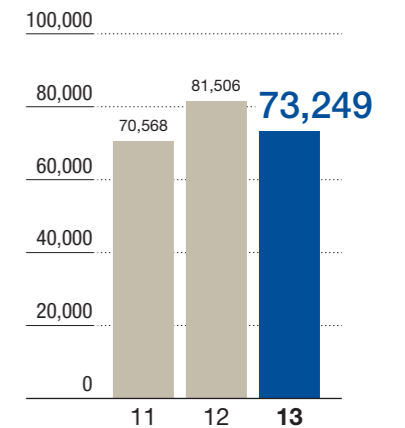
これまでも当社の収益の源泉は技術革新にあると申し上げてきました。2013年3月期においても、研究開発費を732億円と高位維持し、将来成長が期待され

るさまざまな分野において技術開発の一層の強化に努めました。また、近年、MRAM（磁気メモリ）などの新しい半導体デバイスの研究が活発化しています。こうした高度化する半導体デバイスの製造には、既存の技術の延長線だけではなく、最先端の科学理論に基づく技術開発が以前にも増して重要となってきており、東北大学をはじめとするアカデミアとの連携強化を図りました。半導体製造装置メーカーが、大学と連携して新しい半導体デバイスを生みだし、新しい製造装置を生みだしていくといった新たな市場創造に向けた取り組みが始まっています。加えて、550億円を投じて企業買収4件を実施し、優れた製品・技術を外部からも取り込みました。こうした多面的なアプローチにより技術革新を一段と加速させ、今後の東京エレクトロンの成長に繋げてまいります。

多面的なアプローチで技術革新を追求



研究開発費
(百万円)



Q 東会長がCEOとなられて、今後の半導体製造装置市場の発展をどのように考えているのか改めてお聞かせください。また、発展の牽引力となるのは何でしょうか。

A 半導体に求められる技術は、より高度になり多様化しています。これには半導体製造装置の技術革新が不可欠で、我々製造装置の側からブレイクスルーを生みだしていくことが求められています。半導体が進化を続ける限り、製造装置サイドから付加価値の高い製品・ソリューションを提供し続けることで、半導体製造装置市場は、今後も拡大していくと確信しています。

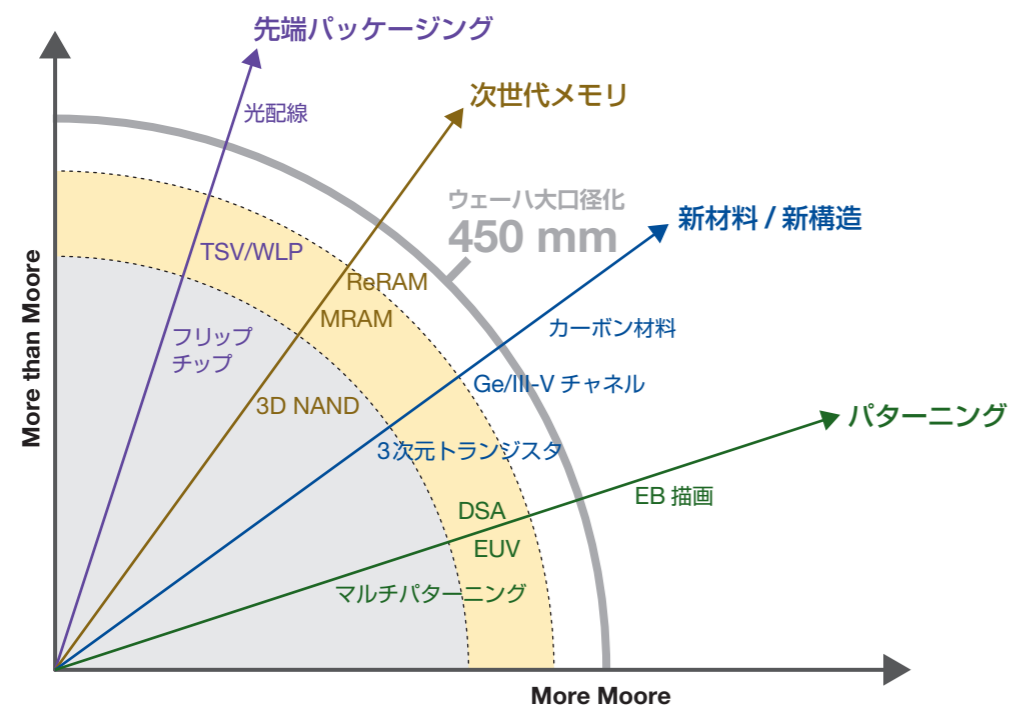
スマートフォン、タブレットをはじめとする先端モバイル機器の本格的な普及に加え、膨大なデータ通信を可能にするクラウド・コンピューティングの飛躍的な発展により、半導体需要は今後も拡大が見込まれています。また数量的な拡大と

CEOインタビュー

同時に、高速化・大容量化・低消費電力化など半導体デバイスに向けた技術的要求は高まる一方です。こうした要求に応えるために、いわゆるムーアの法則、従来のCMOSスケーリングに加え、さまざまな技術革新が起きつつあります（図1）。MRAM（磁気メモリ）などの次世代メモリをはじめ、3次元チップ積層技術などの次世代パッケージング技術に至るまで半導体を取り巻く技術革新に終わりはありません。

新しい半導体デバイスの創造においては、半導体製造装置メーカーの役割は従来にも増して重要となっており、今まで以上にさまざまな技術的課題を解決するソリューションを半導体製造装置の側から提供し、ブレイクスルーを生みだすことが求められています。こうした要求に応じていくことで半導体製造装置市場は、今後も中長期的に成長していくと確信しています。

図1: 多岐にわたる技術開発が半導体の進化を支え、半導体製造装置市場を牽引する



Q 昨年、半導体製造装置事業において企業買収を3件実施されましたが、その狙いをお聞かせください。

A 今回の買収は、いずれも将来技術の獲得を目指したものです。当社の製品・技術と補完し合い、技術開発を一気に加速させ、当社の成長を強固にするものと確信しています。



当社のコア事業である半導体製造装置（SPE）分野の強化のために、NEXX Systems、FSI International、Magnetic Solutionsの買収を実施いたしました。事業拡大を狙う洗浄装置事業における新しい枚葉洗浄技術の獲得、スマートフォン、タブレットの低消費電力化や高速化を可能にする先端パッケージング分野における製品ラインアップの拡充、さらにはDRAMやフラッシュメモリに続く次世代メモリとして有望なMRAM（磁気メモリ）の製造に欠かせない磁場中熱処理技術の獲得など、いずれの買収も新しい半導体デバイスの製造になくてはならない将来技術の獲得を目指したものです。

来たるべき市場拡大に向けて、優れた技術を外部からも取り入れ万全の準備をしています。

SPE 事業強化のための買収を実施

洗浄技術

FSI International, Inc.
(現TEL FSI, Inc.)



先端パッケージング技術

NEXX Systems, Inc.
(現TEL NEXX, Inc.)



MRAM 製造技術

Magnetic Solutions Ltd.
(現TEL Magnetic Solutions Ltd.)



CEOインタビュー

Q Oerlikon Solarを買収し、太陽光パネル製造装置ビジネスに参入する背景をお聞かせください。

A 中長期的な観点で、東京エレクトロンの収益を拡大させていく新たな事業の柱にすることを旨とし、太陽光パネル製造装置市場への参入を決めました。大きな挑戦ですが、当社が長年培った半導体製造装置技術の強みを活かせる分野と考えます。

今後も太陽光発電が拡大していくには、太陽光発電の発電コストが、火力発電などの既存電力の発電コストよりも安くなることが求められています。当社は、Oerlikon Solarの持つ世界最先端の薄膜シリコン型太陽光パネルの技術をベースに、半導体製造装置、フラットパネルディスプレイ製造装置の独自技術を融合することで、発電コスト低減に繋がる装置開発の早期実現が可能であると考え、太陽光パネル製造装置市場へ参入しました。まずは技術の早期確立を目指すことに注力します。

Q トップ交代により株主還元政策の考え方に変更はありますか？

A 当面、当期純利益の35%を目途とする業績連動型の配当方針に変更はございませんが、経営環境および財務基盤を考慮し柔軟に判断していきます。

2013年3月期については、創立50年目を迎えたこともあり、日頃より当社をご支援くださっている株主の皆さまに感謝の意を表し、記念配当20円を加え、通

期で51円の配当とさせていただきます。また、2014年3月期においては、当社の安定的な財務基盤、昨今の世界経済の状況に鑑み、前期と同水準となる通期50円の配当を予定させていただいています。

今後も継続的な利益成長を通じて、企業価値の最大化と直接還元の向上を目指すとともに、自社株買いなどについては状況に応じて柔軟に判断し、株主還元の一層の向上に努めてまいります。

グローバル開発拠点

世界の主要顧客に密着した開発体制により技術革新を加速し、成長を通じて株主価値を最大化する

